

**描述 / Descriptions**

TO-92 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package.

**特征 / Features**

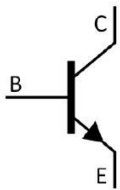
高电流，低电压。

High current, Low voltage.

**用途 / Applications**

用于  $I_c$  电流达 500mA 的中功率放大及开关电路。

Medium power amplifier and switch requiring collector currents up to 500 mA.

**内部等效电路 / Equivalent Circuit****引脚排列 / Pinning**

PIN 1 : Collector      PIN 2 : Base      PIN 3 : Emitter

**放大及印章代码 /  $h_{FE}$  Classifications & Marking**

见印章说明。See Marking Instructions.

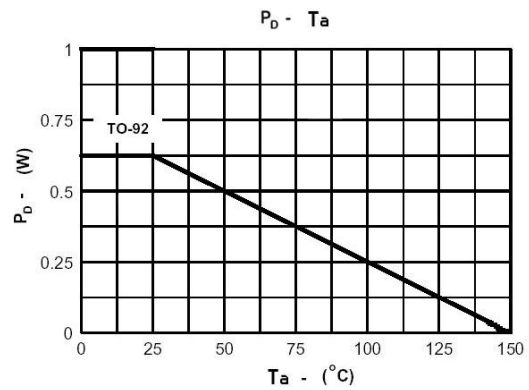
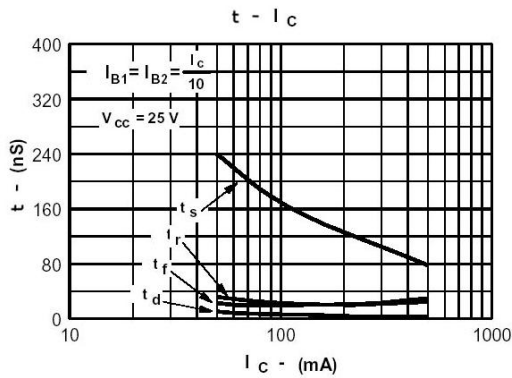
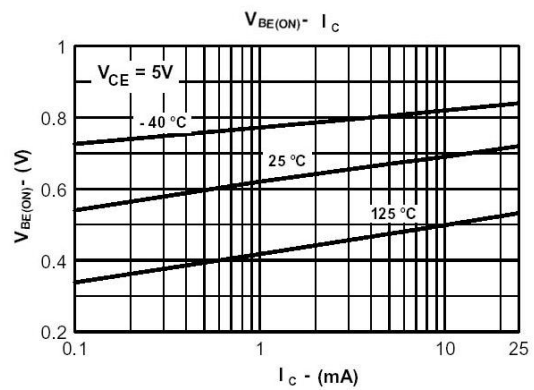
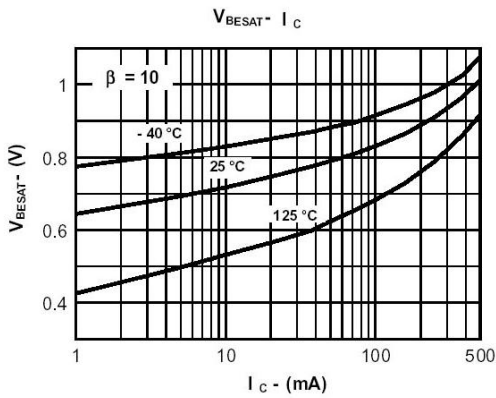
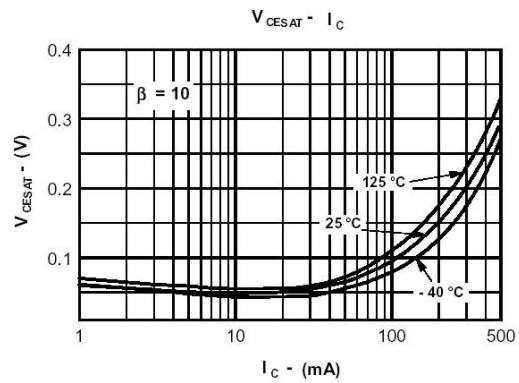
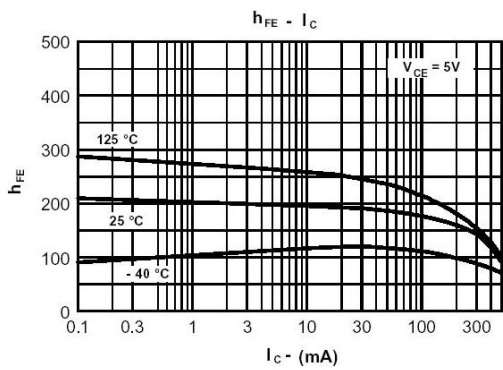
**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	$V_{CBO}$	60	V
Collector to Emitter Voltage	$V_{CEO}$	40	V
Emitter to Base Voltage	$V_{EBO}$	6.0	V
Collector Current - Continuous	$I_C$	600	mA
Collector Power Dissipation	$P_C$	625	mW
Junction Temperature	$T_j$	150	°C
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-55~150	°C

**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	$V_{CBO}$	$I_C=0.1mA$ $I_E=0$	60			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	$V_{CEO}$	$I_C=1.0mA$ $I_B=0$	40			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	$V_{EBO}$	$I_E=0.1mA$ $I_C=0$	6.0			V
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$	$V_{CB}=60V$ $I_E=0$			50	nA
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$	$V_{EB}=6.0V$ $I_C=0$			50	nA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=150mA$	100		300	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=2.0V$ $I_C=500mA$	40			
	$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=10mA$	80			
	$h_{FE(4)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=1.0mA$	40			
	$h_{FE(5)}$	$V_{CE}=1.0V$ $I_C=0.1mA$	20			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)(1)}$	$I_C=150mA$ $I_B=15mA$			0.4	V
	$V_{CE(sat)(2)}$	$I_C=500mA$ $I_B=50mA$			0.75	V
Base to Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)(1)}$	$I_C=150mA$ $I_B=15mA$	0.75		0.95	V
	$V_{BE(sat)(2)}$	$I_C=500mA$ $I_B=50mA$			1.2	V
Current Gain Bandwidth Product	$f_T$	$V_{CE}=10V$ $I_C=20mA$ $f=100MHz$	250			MHz
Delay Time	$t_d$	$V_{CC}=30V$ $I_C=150mA$			15	ns
Rise Time	$t_r$	$I_{B1}=15mA$			20	ns
Storage Time	$t_s$	$V_{CC}=30V$ $I_C=150mA$			225	ns
Fall Time	$t_f$	$I_{B1}=-I_{B2}=15mA$			30	ns

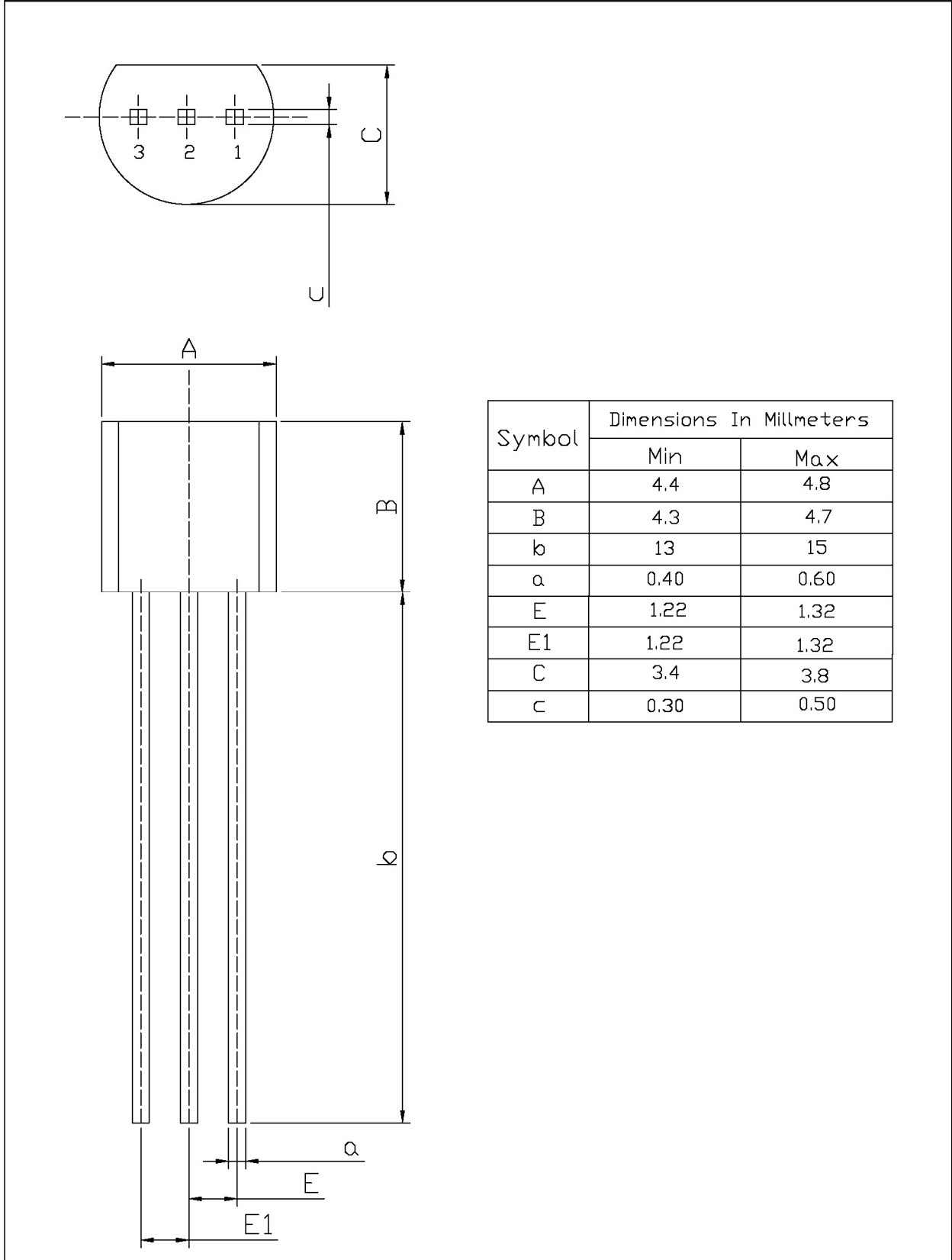
电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



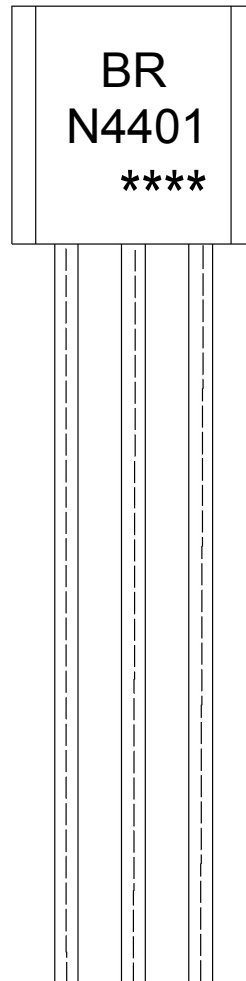
外形尺寸图 / Package Dimensions

TO-92

Unit: mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

N4401： 为型号代码

\*\*\*\*： 为生产批号代码，随生产批号变化。

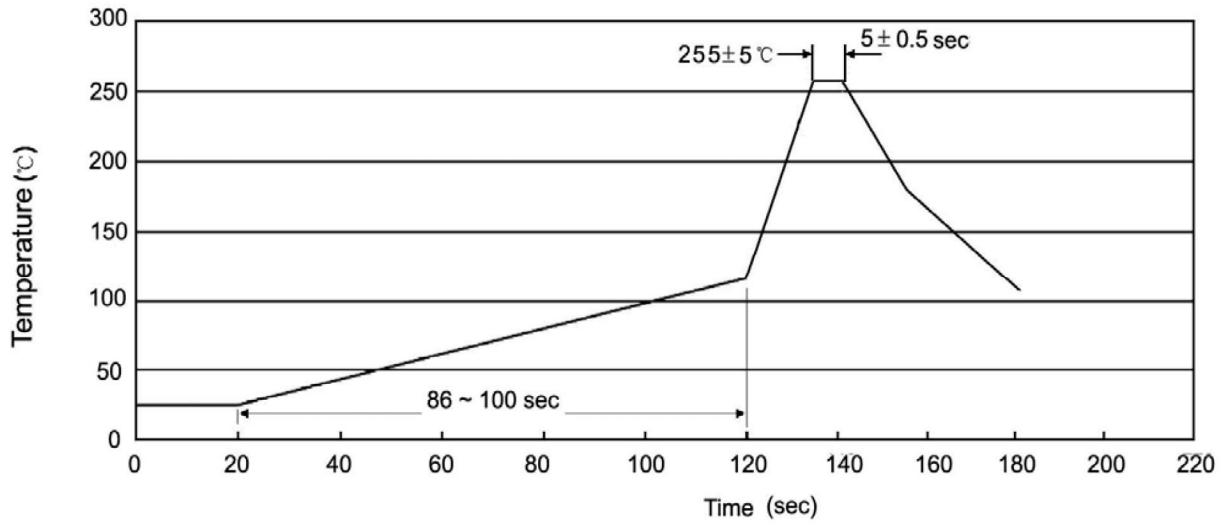
Note:

BR: Company Code.

N4401: Product Type.

\*\*\*\*: Lot No. Code, code change with Lot No.

**波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)**



说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

**耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions**

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

**包装规格 / Packaging SPEC.**

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92	1,000	10	10,000	5	50,000	135×190	237×172×102	560×245×195
	1,000	10	10,000	10	100,000	135×190	237×172×102	560×245×375

编带包装 / AMMO

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)	
	Units/tape 只/纸带	Tape/Inner Box 纸带/盒	Rows/Inner Box 纸带层/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92	3,000	1	120	10	30,000	328×230×42	小箱 480×346×235, 大箱 547×407×268

**使用说明 / Notices**